

申込書は入力フォームとなっております

# マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ ～ソルダリング実装技術の最新動向～

## 【主催】

一般社団法人 日本溶接協会  
マイクロソルダリング要員認証委員会  
マイクロソルダリング要員評価委員会  
マイクロソルダリング教育委員会

## 【共催】

東京大学生産技術研究所

## 【概要】

日時：平成29年10月17日（火）10:30～17:00  
場所：東京大学 リサーチキャンパス（駒場Ⅱキャンパス） コンベンションホール  
参加費用：無料

## 【開催趣旨】

電子・電気製品には目まぐるしく変化する様々な分野の新技术が採用されており、それを支える実装技術では厳しい環境での使用や長期運用など、高い製造技術・材料・評価試験方法・検査方法による高い品質、高い信頼性が求められています。

日本溶接協会では、平成4年よりマイクロソルダリング技術の教育および技術資格の認証を行っており、累計で3万人を超える皆様にご活用頂いております。その資格取得者を中心に様々な方々に対して、最新のマニュアルソルダリング用機器・材料・装置の展示、

最新の技術動向を通じてマイクロソルダリング実装の展開を知って頂く場として、平成18年から「マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ」を開催しております。

本年度は、「ソルダリング実装技術の最新動向」をテーマに、これまでの実装関連の変遷、海外での取り組みや最新の情報をご紹介させて頂くことと致しました。事業主や製造責任者の方々にも参加頂き、基盤技術としてのマイクロソルダリング技術・実装技術を深くご理解頂ければ幸いです。

## 【プログラム】

10:30-10:35	開会の挨拶 マイクロソルダリング要員評価委員会 委員長 藤本 公三
10:35-10:50 (15分)	「マイクロソルダリング技術資格制度の概要」 一般社団法人日本溶接協会 日暮 宏彰
10:50-11:25 (35分)	「ギ酸還元リフロー用ソルダペーストの開発」 株式会社 弘輝 大谷 怜史
11:25-12:00 (35分)	「微細はんだ粉ソルダペーストとその活用」 株式会社 ニホンゲンマ 水野 裕次郎
12:00-12:15 (15分)	展示品紹介 (2分程度/1社)
12:15-13:35 (80分)	昼食休憩・展示見学
13:35-14:10 (35分)	「真空蒸着Sn膜を用いたCuの固液反応拡散接合」 国立大学法人 大阪大学 福本 信次
14:10-14:45 (35分)	「アジアにおける実装技術の教育事情」 白光 株式会社 長瀬 隆、土居 道則
14:45-15:15 (30分)	休憩・展示見学
15:15-15:50 (35分)	「人工衛星搭載機器の品質保証」 NECスペーステクノロジー 株式会社 海老原 伸明
15:50-16:25 (35分)	「スマートフォン基板にみる、実装プロセスの進化と課題」 パナソニック ファクトリーソリューションズ 株式会社 鈴木 泰博
16:25-16:55 (30分)	マイクロソルダリング技術賞 表彰式
16:55-17:00	閉会の挨拶 マイクロソルダリング教育委員会 委員長 加柴 良裕

## 【 参加申込方法 】

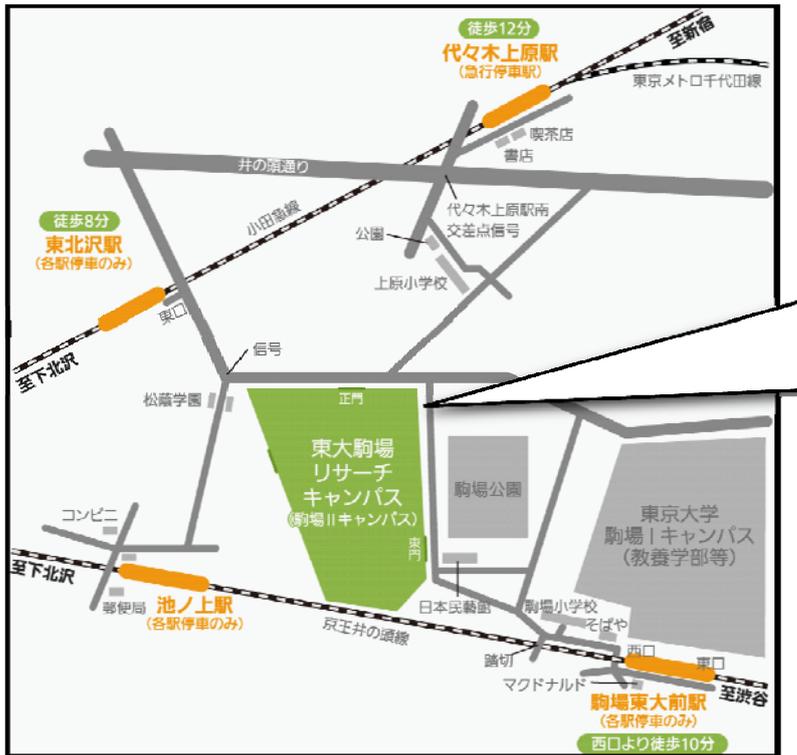
本紙下部の申込書(コピー可)に必要事項を記入し、下記申込先にFAXにて平成29年10月12日までにお送り下さい。受付後、折り返し参加票をFAXにて送付致します。フェスタ当日は、必ず会場受付まで参加票をお持ち下さい。参加票をお持ちでは無い方は、ご入場をお断りする場合がございます。

**会 場**：東京大学 リサーチキャンパス〔駒場Ⅱキャンパス〕An棟 2階 コンベンションホール  
(〒153-8904 東京都目黒区駒場4-6-1)

**参加定員**：230名 (先着順、定員になり次第締切り)

**参加費用**：無 料

**お申込先**：(一社)日本溶接協会 担当：日暮、菅沼 (TEL：03-5823-6325 FAX：03-5823-5211)



### 《会場アクセス》

- 小田急線/東京メトロ千代田線「代々木上原」駅より徒歩12分
- 小田急線「東北沢」駅(東口)より徒歩8分(各駅停車のみ)
- 京王井の頭線「駒場東大前」駅(西口)より徒歩10分(各駅停車のみ)



FAX：03-5823-5211 一般社団法人 日本溶接協会 教育・認証フェスタ 事務局 宛

### 《参加申込書》

ふりがな		
氏名	(姓)	(名)
ふりがな	ふりがな	
勤務先 (所属先名)	電話番号	FAX
同 上 所在地	〒	
E-mail		

※ 複数のお申し込みの場合には、本紙をコピーしてお使い下さい。